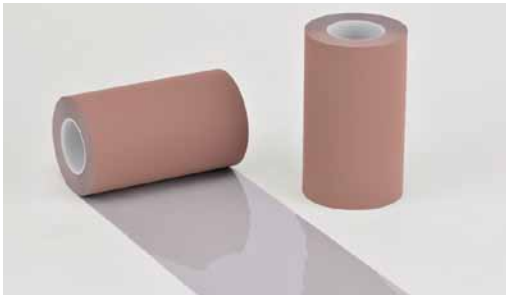


FPC用热固化型 导电性粘接膜

CBF-300 / -W6



CBF-300为热固化型导电性粘接膜。使用金属板作补强板时，通过和FPC电路取得电气连接，金属补强板将作为屏蔽层起到更好接地效果。

特长

▶强化接地

通过和FPC电路取得电气连接，起到强化接地的效果

▶高导电性

使用特殊金属粉，实现体积固有电阻 $10^{-4}\Omega \cdot \text{cm}$ (层压后)的稳定导电性

▶耐无铅回流焊

连接有FPC补强板后，可对应无铅回流焊

▶粘接性

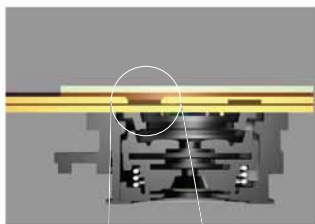
具有与钢片、FR-4、PI等多种基材优异的粘接性

环保适应性

环保型	CBF-300/-W6
无卤素	是
符合RoHS规范	是
适应无铅回流焊	是

CBF-300 / -W6的结构

使用实例：照相模组

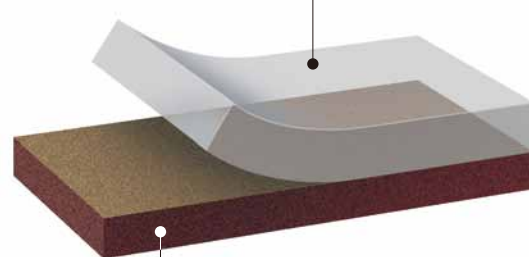


CBF-300/-W6

补强板
(SUS、FR-4、PI等)
FPC

通过金属板作补强和FPC的接地电路取得电气连接。
采用CBF实现高密度化设计

CBF-300 离型膜 (透明)
CBF-300-W6 离型膜 (白色)



多向导电胶层
CBF-300 : 40 μm
CBF-300-W6 : 60 μm